

イントロダクション

重要になるはんだ付けの「技」

IC交換中

マイコンやFPGA, メモリなど百ピンを超えるデジタルICが増えた

全然くっつかないんですけど……

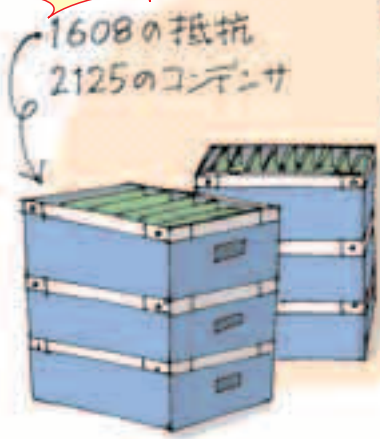


最新デバイスが入手できるようになったけど表面実装部品ばかり…

最新ICは表面実装部品が当たり前



失敗基板を修正してもらいたいけど予算がない…





扱いにくい鉛フリーはんだを使うことになった

ユニバーサル基板に挿入できるパッケージが次々と製造中止に!



持ち運び中に振動や衝撃が加わる携帯機器を作ることが増えた



Ti編集部員(老)の例

高周波回路や高速デジタル回路はチップ部品じゃないと作れない

